

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可在 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 14 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况以及发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会，此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与网络文字互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

- （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:00

(二) 会议召开方式：网络文字互动

(三) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(四) 投资者可在 2024 年 9 月 11 日 (星期三) 16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

独立董事：安广实

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0551-62637000 转 612688

邮箱：stock@nexchip.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日